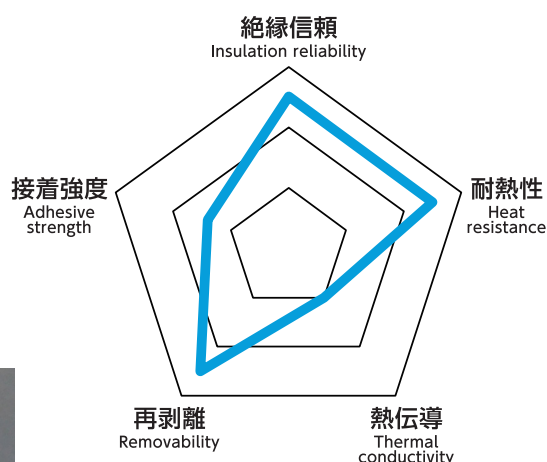


## 糊残りなく剥離可能な耐熱接着テープ

Removable heat resistant tape without adhesive residue

### コンセプト Concept

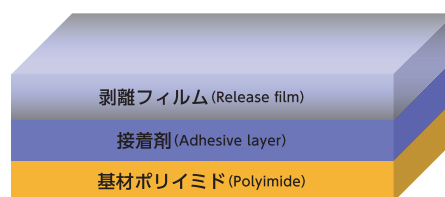
- 熱硬化型の特性を活かし耐熱性と再剥離を両立  
Achieving both heat resistance and removability by using thermosetting
- シロキサンフリー、糊残りなし  
No siloxane and no adhesive residue
- 常温時タック性が無くハンドリング良好  
Good handling with no tackiness at room temperature



### 貼り合わせ条件 Adhesion conditions

	温度 Temperature	速度/時間 Speed/Time	圧力 Pressure
ロールラミネーション Roll lamination	80 ~ 100°C	1m / min	4~8N/cm
プレス Press	100 ~ 120°C	1-10 sec	<0.1 MPa

層構成  
Layer structure



### アプリケーション Application

- 高温環境下でのマスキング (メッキ、半田、溶射等)  
Masking in high temperature environment (plating, soldering, thermal spraying, etc.)
- QFN、ディスクリート、LEDパッケージ等の一括樹脂封止  
Resin encapsulation of QFN, discrete, LED packages, etc.

※QFN : Quad Flat Non-leaded package

※ディスクリート : 単一機能の個別半導体 discrete : discrete semiconductor with single function

